



「JPCA Show 2024 プリント配線板技術展」出展
のお知らせ ～新たな BT 材料、微細配線向け薬液
などを展示～

2024年6月3日

三菱ガス化学株式会社（本社：東京都千代田
区、社長：藤井 政志、以下、当社）は、6月12日
～14日に東京ビッグサイトで開催される「JPCA
Show 2024」において、プリント配線板用積層材
料や微細配線向け薬液を紹介いたします。

HPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)
を実現する半導体パッケージ用低熱膨張BT 材料に
加え、エッジデバイスの小型化・高密度化を実現
薄葉BT材料や高周波用途向け低伝送損失BT材

料、微細回路パターン向け薬液などを出展いたします。

また、JIEP 最先端実装技術シンポジウムにて6月14日には「次世代BTレジン積層材料の技術開発動向」の発表を行います。ご来場の際には、ぜひ当社ブースやJIEP最先端実装技術シンポジウムへお立ち寄りください。

■主な展示製品

- ・半導体パッケージ用 BT 材料

<https://www.mgc.co.jp/products/sc/btprint/lineup/hfbt.html>

- ・LE シート（メカニカルドリリング用エントリーシート）

<https://www.mgc.co.jp/products/sc/lesheet/index.html>

- ・微細配線向け薬液

SAP／M-SAP向けフラッシュエッチング液、
DFR向けアミン系／非アミン系剥離液

DFR前処理／SR前処理向け粗化液、圧延銅箔向
粗化液／粗化液など

■展示会詳細

JPCA Show 2024 プリント配線板技術展

会期 : 2024年6月12日(水)～6月14日(金)

場所 : 東京ビッグサイト 東展示棟 5F-38

WEBサイト : <https://www.jpca2024.com/show2024/index.html>

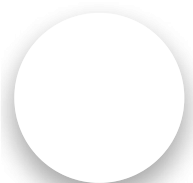
■JIEP最先端実装技術シンポジウム詳細

日時 : 6月14日 10:15-12:45(14B-1セッション)

演題 : 14B1-3 「次世代BTレジン積層材料の技術開発動向」

セミナー詳細 : https://unifiedsearch.jcdbizmatech.jp/jpca2024/jp/sem/jiep/seminar_details/SorP3tlXFjc

以上



お問い合わせ先

三菱ガス化学株

式会社

総務人事部広報

グループ

TEL:03-3283-

5040

お問い合わせ先

[ニュースリリース一覧にもどる](#)